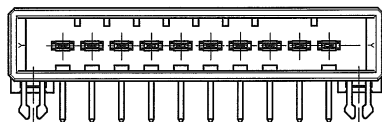
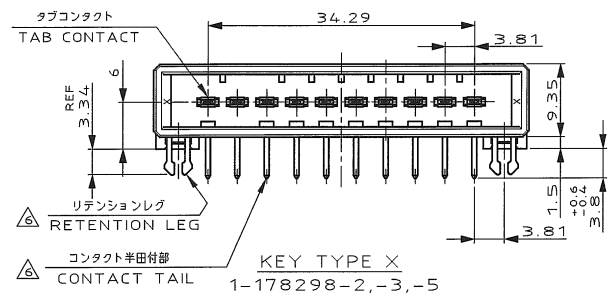
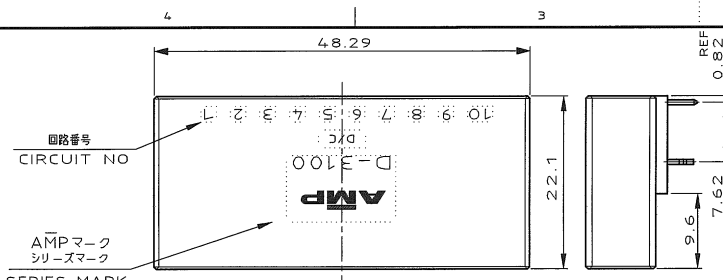
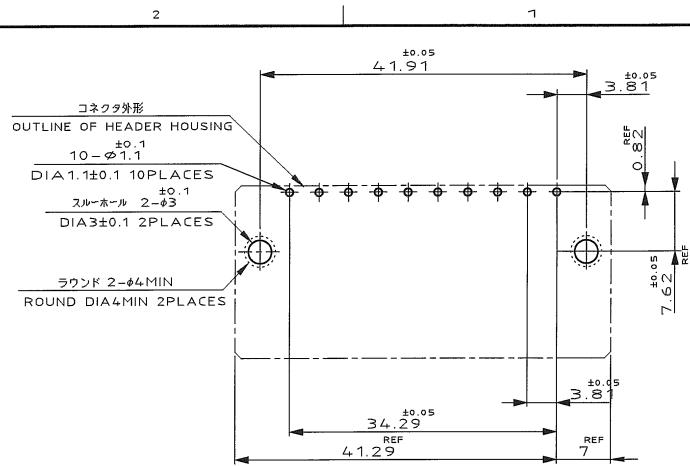


NUMBER 178298  
 METRIC  
 3-D ANGLE PROJECTION  
 PRINT DIST  
 DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT  
 AMP-J  
 REV.10/793



KEY TYPE Y  
2-178298-2, -3, -5



推奨基板取付け寸法  
PC 基板厚: 1.6±0.1  
(非累積公差)  
(コネクタ搭載面)

RECOMMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1  
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER, COLOR: BLACK  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 色: 黒  
コンタクト: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部: 0.38 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部: 0.76 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の土に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の土にスズめっき

Y	2-178298-5	△	△
	2-178298-3	△	△
X	2-178298-2	△	△
	1-178298-5	△	△
	1-178298-3	△	△
KEY TYPE	製品番号 (PART NO.)	(FINISH)	

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

Copyright © 1993  
AMP(Japan) LTD.  
ALL RIGHTS RESERVED.

**tyco**  
Electronics

Tyco Electronics AMP K.K.  
Kawasaki, Japan

WIRE RANGE: mm(TAWG) - - - - -  
INSULATION DIA: - - - - -  
NAME: 10 POS SINGLE ROW  
HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100

MATERIAL: SEE NOTE  
FINISH: SEE NOTE

DR. 20-JAN-93 DE. 20-JAN-93  
Y. TANAKA Y. TANAKA

CHK. 8-FEB-93 APP. 8-FEB-93  
S. MANABE S. MANABE

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)  
100P ±0.3  
1000R 200P ±0.4  
3000R 1000P ±0.5

SIZE LOC NUMBER  
A3 J C-178298

SCALE 2-1 REV. B SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面